

**【表紙】**

【提出書類】	四半期報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年8月14日
【四半期会計期間】	第31期第2四半期（自 2023年4月1日 至 2023年6月30日）
【会社名】	ウインテスト株式会社
【英訳名】	Wintest Corp.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 姜 輝
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市西区平沼一丁目2番24号
【電話番号】	045-317-7888（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役 樋口 真康
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市西区平沼一丁目2番24号
【電話番号】	045-317-7888（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役 樋口 真康
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

## 第一部【企業情報】

### 第1【企業の概況】

#### 1【主要な経営指標等の推移】

回次	第30期 第2四半期 連結累計期間	第31期 第2四半期 連結累計期間	第30期
会計期間	自 2022年1月1日 至 2022年6月30日	自 2023年1月1日 至 2023年6月30日	自 2022年1月1日 至 2022年12月31日
売上高 (千円)	109,774	186,416	210,315
経常損失 ( ) (千円)	323,882	239,355	683,764
親会社株主に帰属する四半期(当期) 純損失 ( ) (千円)	325,120	240,594	686,241
四半期包括利益又は包括利益 (千円)	248,370	207,729	652,516
純資産額 (千円)	1,552,737	1,578,060	1,352,717
総資産額 (千円)	1,927,495	1,910,504	1,902,244
1株当たり四半期(当期)純損失 ( ) (円)	9.59	6.29	19.87
潜在株式調整後1株当たり四半期 (当期)純利益 (円)	-	-	-
自己資本比率 (%)	80.0	82.1	70.6
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)	245,372	306,840	613,481
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)	-	300	3,880
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)	321,711	260,568	667,984
現金及び現金同等物の四半期末(期 末)残高 (千円)	307,041	232,488	278,480

回次	第30期 第2四半期 連結会計期間	第31期 第2四半期 連結会計期間
会計期間	自 2022年4月1日 至 2022年6月30日	自 2023年4月1日 至 2023年6月30日
1株当たり四半期純損失 ( ) (円)	4.63	2.58

(注) 1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2. 第30期第2四半期連結累計期間、第30期及び第31期第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。

#### 2【事業の内容】

当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

なお、当社グループは、従来報告セグメントの「半導体検査装置事業」及び報告セグメントに含まない「その他」の2つにセグメントを区分しておりましたが、第1四半期連結会計期間より「半導体検査装置事業」の単一セグメントに変更しております。詳細は「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。

## 第2【事業の状況】

### 1【事業等のリスク】

当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

なお、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況につきましては、次のとおりであります。

(継続企業の前提に関する重要事象等について)

当社グループは、前連結会計年度において半導体需要のダブつきによる工場稼働率の調整の影響を受け、売上・受注時期がずれ込み、売上高210,315千円にとどまり、営業損失693,502千円、親会社株主に帰属する当期純損失686,241千円を計上いたしました。また、営業キャッシュ・フローは、613,481千円のマイナスとなりました。

当第2四半期連結累計期間においては、2022年8月から顕在化した民生向け半導体の在庫調整も2023年上半年には一段落するものと予測されておりましたが、在庫調整の回復にはまだ時間がかかる見込みです。そのため、2023年6月末時点において、スマートフォンやPCなどの需要低迷の影響から、主にそれら機器で使用される半導体を中心にだぶつき感が否めない状況が続いており、顧客の各工場が、生産調整に入っていることから当第2四半期連結累計期間中の受注は低調に推移しました。顧客の新規設備投資は当社第3四半期以降に開始される見込みです。

以上より、当第2四半期連結累計期間の売上高は186,416千円にとどまり、営業損失249,453千円、親会社株主に帰属する四半期純損失240,594千円を計上しております。また、営業キャッシュ・フローは、306,840千円のマイナスとなりました。

上記のとおり、継続的な営業損失及び営業キャッシュフローのマイナスが発生している状況にあり、当社グループには継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社グループはこうした状況を早期に解消又は改善すべく、以下の対応策を継続して実施しております。

#### 事業施策

##### 1. 中国国内での受注販売活動の促進

まず、上記で述べたように2022年8月から顕在化していた民生向け半導体の在庫調整も2023年上半年中には一段落するものと予測されておりましたが、回復にはまだ時間がかかる状況であり、半導体チップ、特に民生機器の一部である、スマートフォンやPC、そしてIT情報端末機器などの半導体製品にだぶつき感が発生し、各半導体工場における在庫抑制を目的とした生産調整が発生しました。そのためスマートフォンやPC向けパネルそしてパネルを駆動するLCDドライバーチップ等の在庫増が嫌気され、デザインハウス及び大手OSATを中心に工場の稼働率は回復の兆しはあるものの、現時点では7割から8割程度であり、市場は新規設備投資に慎重な姿勢を崩しておりません。しかし、2024年を含む中期的には、自動車の電動化、再生エネルギー関連及び5Gへの投資需要が強く見込まれており、また、急速に需要が高まっている生成人工知能(AI)も半導体チップの需要を押し上げる要因となっていることから、市場は力強く成長すると見られております(Electronic Engineering Timesより、以下「EETIMES」という。)

また、近年の半導体の複雑化や集積度向上(例、線幅4nmから2nm)は半導体の機能の増加を意味し、検査時間の伸長に繋がります。しかしながら、同時に量産性も要求されるため、半導体検査市場は、装置能力の向上に加えて装置台数の増加が期待される方向と考えられております。

当社グループが「主力装置」と位置付けるLCDドライバIC検査装置は、スマートフォンやPC等の情報端末の液晶パネルの駆動に使われる「ディスプレイドライバーIC」の検査に使用されております。また、それら情報端末には、「CMOSイメージセンサーIC」、「ロジックIC」など多種に渡る周辺半導体デバイスが使われております。現状足元では、上記のように半導体市場の足踏み状態が続いておりますが、中長期的には需要も戻り、大きな伸びが期待される分野です。

上述のような理由から当第2四半期連結累計期間中では、受注は低迷致しましたが、当社の主力検査装置「WTS-577SR」につきましては、2021年から販売を開始し、当第2四半期連結累計期間において、進化する新デバイスに向けた装置の貸出しを伴うベンチマークを積極的に進め、お客様から量産ラインへの投入評価をいただくことができました。

2023年の半導体市場は、世界半導体市場統計(WSTS)や日本貿易振興機構(JETRO)等の予想では、民生向け半導体(スマートフォン、PC向け半導体等)を中心として、依然として生産調整が2023年後半まで続くとの見方があります。他方、半導体製造装置セクターにおいては、2023年前半は落ち込むが後半から2024年にかけて徐々に回復との予測もあり、当社においては、半導体検査装置の受注は2023年2月14日に公表している通期予想に組込んでおります。

新戦略として、2023年3月6日に開示いたしましたとおり、新たに日本における大手再生シリコンウエーハ製造会社である株式会社RSテクノロジーズ(東京都品川区、代表取締役方永義)を販売店に迎え、国内外の受注拡大を狙います。

また、当社の中国製造子会社「偉恩測試技術(武漢)有限公司」(以下、「ウインテスト武漢」という。)の営業体制の拡大強化を行い、特に中国、台湾においての直接受注を目指します。また、海外営業と海外アフターサポート体制の拡充を進め、営業活動の再構築を図ってまいります。

次に、ウインテスト武漢においては、顧客対応力の強化、更なる最終組立工程の製造品質の向上に取り組み、中国国内市場への深耕を図ってまいります。

さらに中国市場攻略のスピードアップを進めるため、ウインテスト武漢において、大手優良デザインハウス数社に的を絞った戦略を取り、関連するOSATへの貸出を進め、営業・納入・サポートと一貫体制を敷き、顧客からの信頼獲得を図ってまいります。

## 2．技術開発の強化

先端口ジックIC検査装置（1024チャンネル、820Mbps）に関しては、第1四半期に前倒しで一部機能のリリースを行い、引続き次世代向け機能としてロジックパターンスピードが1,600Mbpsとなる高速リソースの開発を継続しており、当第4四半期中には開発を終了し、お客様への提供を開始する予定です。更に「WTS-9000S」次世代のフラッグシップ検査装置に先立ち「WTS-577SX」のリリースを同じく当第4四半期を目途に計画しております。「WTS-577SX」に関して、国内、台湾、中国顧客向けを想定した開発を継続しており、多くの部分を現在開発中の次世代LCDドライバー検査装置へ共用の上、使い勝手の向上に向けて新GUIを装備し、コスト削減と市場への早期リリースができるように計画しております。

また、新たな収益の柱を構築するための成長戦略として、当社グループがこれまで培ってきた検査技術や画像処理技術、高精度センサー技術、データ解析技術を応用し、且つ当社、ウインテスト武漢の技術陣に加え、現地有力企業より営業方面・技術方面での協力体制を構築することで、2025年までに、今後市場拡大が見込まれるシステムオンチップ(SoC)市場や汎用デジタル市場等の検査分野、そしてM&Aも計画し、日本市場においても注目を集めるパワーデバイス検査分野への進出を目指し、資本提携や協力体制を積極的に進め、新規市場参入、対応可能検査範囲の拡充と展開を行い、収益基盤の拡充に取り組んでまいります。

## 3．隣接領域の展開と製品化

検査装置向け工場FA化機器技術（「自重補償機構技術」）については、学校法人慶應義塾大学慶應義塾先端科学技術研究センターと共同開発を進めており、特許等の申請については、既にお知らせのとおり手続きは終了しております。当該技術は当社の検査装置とウエーハ搬送装置との間のドッキングアダプター（以下「ポゴタワー」という。）の着脱（約25kg～30kg）をオペレーター人で簡単に安全に行うための補助アーム（以下「マニピュレータ」という。）で製品化を目指し、当面の目標として、その搬送可能重量を50kg前後で製品化を行います。現在は、製品の製造準備に取り掛かっており、先端口ロボット等の開発製造をロボット等製造事業者様と協議を開始いたしました。また当該技術は、「半導体製造工場内FA化システム」、「物流搬送システム」並びに「介護等」への応用が可能と考えております。

奈良県立大学と進めております脈波（BCG, ECG）を利用したヘルスケア管理システムは、同大学並びに株式会社TAOS研究所とアライアンスを組み、製品化を行いました。2023年3月9日に開示しました「IoTセンサーを活用したセルフヘルスケア機器の販売開始決定及び価格に関するお知らせ」に記載いたしましたとおり、2023年4月1日より一部のお客様を中心に試験販売を開始いたしました。なお、当該製品の製造に関しましては当社大阪事業所で製造を行うように準備を進めており、2023年9月から順次市場投入を計画しております。また、製品の納品後もアップデートによる機能の追加、検査項目の拡充を積極的に進め、地域医療に貢献できるようにしてまいります。なお、機器の詳細につきましては、当社WEBページをご参照ください。

## 財務施策

財務面については、事業拡張を考えた財務戦略として、筆頭株主である武漢精測と諮りながら、武漢精測グループ及び投資機関からの資本増強あるいは同グループからの借入を計画し、資金確保についての施策を今後とも継続実施してまいります。

## 2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

### (1) 経営成績の状況

当第2四半期連結累計期間（2023年1月1日～2023年6月30日）における世界半導体市場を、2023年4月時点での半導体世界売上高で分析すると、前月比で僅かながら0.3%増加し、これにより2か月連続で前月を上回る結果となりましたが、この成長は、特に中国市場の回復によるものでした。中国は金融の緩和を行っているものの、水面下ではゼロコロナ政策と同様の規制を続けており、2022年8月から2023年2月までの7か月間、半導体売上高が前月比で減少していました。しかし、中国の半導体売上高は、2023年3月にわずかながら増加し始め、4月には増加率が1.7ポイント上昇して、2.9%の成長を記録しました。中国の半導体売上高は、世界全体の売上高の約28.6%を占め、依然として世界最大の市場となっています。このように一部では回復の兆しはみられるものの、同市場における投資は限定的で、例えば、当第2四半期連結累計期間の前年同月比では、半導体世界売上高は21.6%減少しております。この前年比の減少は、2022年8月から続いており、当初は2023年上半期には在庫調整も一段落するものと予測されておりましたが、回復にはまだ時間がかかるとされています（WSTS及び日経誌データより）。半導体産業は、マクロ経済の低迷や景気の先行き不透明性、在宅需要のピークアウト、インフレーション、地政学的リスクなどの要因によって影響を受けており、2023年6月末時点においてもまだ、スマートフォンやPC、民生機器などの需要低迷が響き、同機器で使用される半導体を中心にだぶつき感が否めない状況が続いています。

ただし、自動車の電動化や再生エネルギー関連の用途においては、需要が引続き強く見込まれており、また、急速に需要が高まっている生成人工知能（AI）も一部のロジックICの需要を押し上げる要因となっています。

半導体産業の統計を提供するWSTSは、2023年通年の半導体世界市場を前年比で10.3%縮小すると予測しています。これによれば、2023年は2019年以來の4年ぶりの市場縮小となる見込みですが、2024年には、市場が回復し、前年比で11.8%の増加を記録するとの見通しも示しています。

日本市場においては、2023年は自動車用途などの半導体需要の下支えによって前年比1.9%成長すると予測され、市場規模は約6兆4,494億円に達するとされています。そして、2024年には成長が加速し、同市場は7.8%成長して約6兆9,537億円に達するとの予測があります。

このような環境下、2023年度における当社グループの主要事業である半導体検査装置事業分野では、EETIMESから引用すると、中国向けを含む市場規模として、前年比23%減の3兆201億円と予測されています。この予測は、半導体の需要低迷が長引いたことによる大幅な下方修正が背景にあります。しかし、2024年以降は、生成人工知能（AI）向けのデータセンターの拡大や電気自動車（EV）、仮想現実（VR）端末の普及により、需要回復が期待されています。世界的な景気の低迷により、半導体製造装置の世界売上高も2023年には前年比19%減の874億ドルになる見通しで、PCやスマホ向け半導体を製造する、韓国サムスン電子や米マイクロン・テクノロジーも大幅な生産調整による減産を行っており、特にメモリーやロジック分野の装置売上高は28%減、市場を引っ張ってきたNAND分野も51%減の見通しです。しかし、中国景気の回復などで民生品の需要が上向き、2024年には再び1,000億ドル台を回復すると見られています。当社としては、市場の上昇機運は未だ弱いものの、より高速高精度な半導体、特に高画素化が求められるLCDドライバーICに注力し、引続きお客様のニーズを取り込んだ、既存装置の改良、改善そして次世代デバイス向け検査装置の開発を継続することで、2023年下半年から2024年かけて回復が予想される当該市場に注力してまいります。

当第2四半期連結累計期間においては、上述のように、お客様工場の在庫のだぶつきから生産調整による受注の遅れがあったことから受注及び売上は低迷いたしました。営業面では販売店に集中させていた、販売方法を見直し当社の製造子会社の営業を含めた直接販売を拡大することとし、現地マーケットに集中した営業展開を2023年8月より本格化いたしました。

この結果、当第2四半期連結累計期間の当社グループの売上高は186,416千円（前年同四半期比69.8%増）、営業損失249,453千円（前年同四半期は営業損失349,286千円）、経常損失239,355千円（前年同四半期は経常損失323,882千円）、親会社株主に帰属する四半期純損失240,594千円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失325,120千円）となりました。

なお、セグメント区分については、従来報告セグメントの「半導体検査装置事業」及び報告セグメントに含まない「その他」の2つにセグメントを区分しておりましたが、第1四半期連結会計期間より「半導体検査装置事業」の単一セグメントに変更しております。

これは、「その他」の事業セグメントに含まれておりましたオーディオ事業を株式会社データゲート（大阪府大阪市北区）に事業譲渡を行ったことにより、「その他」に含まれていた事業がなくなったため、報告セグメントを「半導体検査装置事業」の単一セグメントとして管理することが適切と判断したためであります。

### (2) 財政状態に関する説明

#### (資産)

当第2四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度に比べ8,313千円増加し、1,885,614千円（前連結会計年度末比0.4%増）となりました。この主な要因は、売掛金が66,462千円増加したものの、現金及び預金が45,991千円減少したことによるものです。

固定資産は、前連結会計年度に比べ53千円減少し、24,889千円（前連結会計年度末比0.2%減）となりました。この主な要因は、投資その他の資産のその他が53千円減少したことによるものです。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度に比べ200,595千円減少し、173,139千円（前連結会計年度末比53.7%減）となりました。この主な要因は、短期借入金が157,030千円減少したこと、買掛金が14,249千円減少したこと及び未払金が20,217千円減少したことによるものです。

固定負債は、前連結会計年度に比べ16,487千円減少し、159,304千円（前連結会計年度末比9.4%減）となりました。この主な要因は、長期借入金が16,449千円減少したことによるものです。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度に比べ225,342千円増加し、1,578,060千円（前連結会計年度末比16.7%増）となりました。この主な要因は、資本金及び資本剰余金が各々が216,669千円増加し、利益剰余金が240,594千円減少したことによるものです。

### （3）キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて45,991千円減少し、当第2四半期連結会計期間末には232,488千円となりました。

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果減少した資金は306,840千円（前年同四半期は、245,372千円の減少）となりました。これは主に、売上債権の増加額44,385千円、仕入債務の減少額23,357千円及び税金等調整前四半期純損失239,355千円等による資金の減少があったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果減少した資金は300千円（前年同四半期は、増減がありませんでした）となりました。これは、敷金・保証金支払いによる支出が300千円あったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果増加した資金は260,568千円（前年同四半期は、321,711千円の増加）となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出が156,235千円があったものの、新株予約権の行使による株式の発行による収入が428,424千円があったことによるものです。

### （4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更はありません。

### （5）研究開発活動

当第2四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は113,597千円であります。

なお、当第2四半期連結累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

## 3【経営上の重要な契約等】

当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

### 第3【提出会社の状況】

#### 1【株式等の状況】

##### (1)【株式の総数等】

###### 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	50,000,000
計	50,000,000

###### 【発行済株式】

種類	第2四半期会計期間 末現在発行数(株) (2023年6月30日)	提出日現在 発行数(株) (2023年8月14日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	39,972,000	39,972,000	東京証券取引所 スタンダード市場	単元株式数100 株
計	39,972,000	39,972,000	-	-

##### (2)【新株予約権等の状況】

###### 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

###### 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

##### (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

当第2四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されております。

	第2四半期会計期間 (2023年4月1日から 2023年6月30日まで)
当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)	18,425
当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株)	1,842,500
当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)	104
当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(円)	191,617,500
当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)	39,000
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)	3,900,000
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)	110
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(円)	428,424,200

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2023年4月1日～ 2023年6月30日	1,842,500	39,972,000	96,969	1,427,232	96,969	1,427,232

(注) 1. 当社は、当第2四半期連結会計期間に、第三者割当の方法による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）の権利行使による新株発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ96,969千円増加しております。

2. 2023年1月13日付「有価証券届出書」及び2023年1月19日付「有価証券届出書の訂正届出書」にて提出いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 2 新規発行による手取金の使途（2）手取金の使途」については、2023年8月4日付「資金使途変更に関するお知らせ」及び2023年8月7日付「資金使途の変更についてのお知らせ」の一部訂正について」で開示いたしましたように、以下のとおり変更いたしました。

(1) 変更の理由

2022年末まで世界を翻弄した新型コロナ禍も一段落し、世界はウイズコロナ、アフターコロナに向かって進み始めました。当社は半導体市場成長の著しい中国、そしてそれら半導体のデザインハウスの多い台湾方面をメイン市場と捉え、新機能の充実を目的に主力検査装置の更なる競争力アップ、営業力拡大を意図し、業績の向上を目的に2023年1月13日に公表いたしましたとおり、GFA株式会社を割当先とする第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行を行うことを決議し、その資金使途として、当時特に不足していた一部半導体部材の仕入れ並びに、次世代装置の開発や技術者の増強、それに伴う大阪事業所の移転増強並びに増加運転資金としてまいりました。

それらの資金充当に関し、主な変更を行う理由に関しまして、調達資金が7千万円近く減少したこと並びに、それまで半導体市場をけん引してきたテレワーク需要などが終息に向かい、2022年秋頃から顕在化してきたPCやスマートフォン、一部情報端末機器向け需要が大幅に減速し、特にPCやスマホ関連の半導体が想定以上にダブつくこととなり、顧客の設備投資が急減速したことを背景に、今般、市場戦略の見直しを行い、一部の資金使途については、削減したためとなります。

(2) 変更の内容

資金使途の変更内容は以下のとおりであります。（変更箇所は下線で示しております。）

（変更前）

具体的な使途	金額（円）	充当予定時期
装置製造に関わる半導体部材仕入れ等	130,000,000	2023年1月～2023年10月
次世代先端システム開発費、パリエーション展開	100,000,000	2023年1月～2023年12月
技術者増強(技術営業、開発、サポート)	100,000,000	2023年3月～2024年12月
製造工場移転増強	70,000,000	2024年3月～2025年12月
その他運転資金	98,114,000	2023年1月～2024年12月

（変更後）

具体的な使途	金額（円）	充当予定時期
装置製造に関わる半導体部材仕入れ等	70,000,000	2023年1月～2023年12月
次世代先端システム研究開発費 Ver.1	30,000,000	2023年1月～2023年8月
技術者増強(技術営業、開発、サポート)	70,000,000	2023年1月～2023年8月
当社100%子会社（ウインテスト武漢）への貸付 (拠点移転費用、資材購入、運転資金)	120,000,000	2023年8月
その他当社運転資金	140,088,200	2023年1月～2023年8月
合計	430,088,200	

（変更前） で予定していた装置製造に関わる部材仕入れは、2023年上半年期までの市場低迷が大きく響き、新規受注が低迷したため、製造部材在庫を見直し、減少させております。（変更前） 次世代先端システム開発関連は一部を前倒しし、バージョン1（注参照）とバージョン2（注参照）に分け、今回はバージョン1のみに集中する戦略を取り予算の縮小をします。なお、（変更前） で計画していた開発・サポート技術者の増強に関し、変更後は、規模を縮小し、若干名を補充するにとどめ、引続き、2024年度以降の予算で行うこととしております。（変更前） で計画していた、大阪工場の移転につきましては、調達予定資金が予定金額に届かなかったことで、今回の増資資金では移転が難しいと判断、2024年以降に再度計画することとし、延期といたしました。しかし、中国における顧客サポートの多様化への対応と、顧客要求への即応性ニーズが今後の当社事業へ重要になると判断し、当社100%子会社であるウインテスト武漢の営業・サポート拠点の移転並びに、武漢工場における新規開発装置向け部材の購入他で、当社子会社への貸付を行います。（変更前） の運転資金に関しましては、想定以上の諸物価の高騰などの影響を受けて（変更後） のように増加することとなりました。



注 バージョン1 次世代信号発生器を完成させ、既存筐体に組込み機能をアップさせたもの  
バージョン2 次世代信号発生器並びに信号取り込み、筐体すべてが新開発品となる装置

(5)【大株主の状況】

2023年6月30日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式(自己 株式を除く。)の 総数に対する所有 株式数の割合 (%)
Wuhan Jingce Electronic Group Co., Ltd. ( 常任代理人 三田証券株式会社 取締役社長 門倉 健仁 )	11th Floor, Building 1, 48# (Beigang Industrial Park), Shucheng Road, Hongshan District, Wuhan City, Hubei Province, PRC ( 東京都中央区日本橋兜町3番11号 )	20,000,000	50.03
大畑 雅稔	静岡県静岡市清水区	1,538,300	3.84
楽天証券株式会社	東京都港区南青山2丁目6番21号	1,459,700	3.65
株式会社SBI証券	東京都港区六本木1丁目6番1号	460,740	1.15
FUBON SECURITIES CO., LTD. CLIENT 30 ( 常任代理人 シティバンク、エ ヌ・エイ東京支店 ダイレクト・カ ストディ・クリアリング業務部長 石川 潤 )	4/F., NO.108, SEC1, TUN HWA S.RD., TAIPEI 105, TAIWAN. ( 東京都新宿区新宿6丁目27番30号 )	392,800	0.98
UBS AG HONG KONG ( 常任代理人 シティバンク、エ ヌ・エイ東京支店 ダイレクト・カ ストディ・クリアリング業務部長 石川 潤 )	AESCHENVORSTADT 1 CH-4002 BASEL SWITZERLAND ( 東京都新宿区新宿6丁目27番30号 )	375,000	0.93
いちよし証券株式会社	東京都中央区日本橋茅場町1丁目5番8号	316,400	0.79
松村 正人	神奈川県座間市	156,100	0.39
松井証券株式会社	東京都千代田区麹町1丁目4番地	147,100	0.36
日本証券金融株式会社	東京都中央区日本橋茅場町1丁目2-10号	140,800	0.35
計	-	24,986,940	62.51

(6)【議決権の状況】  
【発行済株式】

2023年6月30日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	-	-	-
議決権制限株式(自己株式等)	-	-	-
議決権制限株式(その他)	-	-	-
完全議決権株式(自己株式等)	-	-	-
完全議決権株式(その他)	普通株式 39,966,200	399,662	-
単元未満株式	普通株式 5,800	-	1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数	39,972,000	-	-
総株主の議決権	-	399,662	-

【自己株式等】

該当事項はありません。

2【役員の状況】

該当事項はありません。

## 第4【経理の状況】

### 1．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

### 2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間（2023年4月1日から2023年6月30日まで）及び第2四半期連結累計期間（2023年1月1日から2023年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、フロンティア監査法人による四半期レビューを受けております。

## 1【四半期連結財務諸表】

## (1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金及び預金	278,480	232,488
売掛金	21,058	87,520
電子記録債権	21,670	-
商品及び製品	215,344	193,499
仕掛品	797,167	820,702
原材料及び貯蔵品	506,251	532,306
前渡金	8,677	836
未収消費税等	13,270	4,029
その他	15,381	14,232
流動資産合計	1,877,301	1,885,614
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物	8,182	8,182
減価償却累計額	8,182	8,182
建物(純額)	-	-
車両運搬具	8,885	8,885
減価償却累計額	8,885	8,885
車両運搬具(純額)	-	-
工具、器具及び備品	181,952	181,952
減価償却累計額	181,952	181,952
工具、器具及び備品(純額)	-	-
有形固定資産合計	-	-
<b>投資その他の資産</b>		
その他	27,827	27,773
貸倒引当金	2,884	2,884
投資その他の資産合計	24,943	24,889
固定資産合計	24,943	24,889
資産合計	1,902,244	1,910,504

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	21,750	7,500
1年内返済予定の長期借入金	32,064	32,064
短期借入金	157,030	-
未払金	75,020	54,802
未払法人税等	10,689	9,483
契約負債	45,696	34,899
製品保証引当金	300	552
その他	31,183	33,835
流動負債合計	373,734	173,139
固定負債		
長期借入金	169,030	152,581
リース債務	343	257
資産除去債務	6,418	6,466
固定負債合計	175,791	159,304
負債合計	549,526	332,444
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,210,563	1,427,232
資本剰余金	1,497,050	1,713,719
利益剰余金	1,468,555	1,709,149
株主資本合計	1,239,059	1,431,802
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	104,158	137,023
その他の包括利益累計額合計	104,158	137,023
新株予約権	9,500	9,234
純資産合計	1,352,717	1,578,060
負債純資産合計	1,902,244	1,910,504

## (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

## 【四半期連結損益計算書】

## 【第2四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
売上高	109,774	186,416
売上原価	79,883	91,015
売上総利益	29,890	95,401
販売費及び一般管理費	379,176	344,854
営業損失( )	349,286	249,453
営業外収益		
受取利息	38	26
為替差益	26,737	14,605
その他	737	1,770
営業外収益合計	27,512	16,402
営業外費用		
支払利息	1,623	3,348
支払手数料	-	1,811
その他	484	1,145
営業外費用合計	2,108	6,305
経常損失( )	323,882	239,355
税金等調整前四半期純損失( )	323,882	239,355
法人税、住民税及び事業税	1,238	1,238
法人税等調整額	-	-
法人税等合計	1,238	1,238
四半期純損失( )	325,120	240,594
親会社株主に帰属する四半期純損失( )	325,120	240,594

## 【四半期連結包括利益計算書】

## 【第2四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
四半期純損失( )	325,120	240,594
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	76,749	32,864
その他の包括利益合計	76,749	32,864
四半期包括利益	248,370	207,729
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	248,370	207,729
非支配株主に係る四半期包括利益	-	-

## (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純損失( )	323,882	239,355
製品保証引当金の増減額( は減少)	1,607	252
受取利息及び受取配当金	38	26
支払利息	1,623	3,348
為替差損益( は益)	15	0
売上債権の増減額( は増加)	22,343	44,385
棚卸資産の増減額( は増加)	25,921	26,951
前渡金の増減額( は増加)	9,623	7,851
仕入債務の増減額( は減少)	59,612	23,357
未払又は未収消費税等の増減額	38,292	9,241
その他	32,553	41,560
小計	254,797	301,041
利息及び配当金の受取額	38	26
利息の支払額	1,623	3,348
法人税等の支払額	848	2,477
法人税等の還付額	11,858	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	245,372	306,840
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
敷金及び保証金の差入による支出	-	300
投資活動によるキャッシュ・フロー	-	300
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の返済による支出	-	156,235
長期借入れによる収入	120,000	-
長期借入金の返済による支出	13,275	16,449
リース債務の返済による支出	459	85
新株予約権の発行による収入	3,625	4,914
新株予約権の行使による株式の発行による収入	213,376	428,424
その他	1,556	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	321,711	260,568
現金及び現金同等物に係る換算差額	11,593	580
現金及び現金同等物の増減額( は減少)	87,932	45,991
現金及び現金同等物の期首残高	219,109	278,480
現金及び現金同等物の四半期末残高	307,041	232,488



## 【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

当社グループは、前連結会計年度において半導体需要のダブつきによる工場稼働率の調整の影響を受け、売上・受注時期がずれ込み、売上高210,315千円にとどまり、営業損失693,502千円、親会社株主に帰属する当期純損失686,241千円を計上いたしました。また、営業キャッシュ・フローは、613,481千円のマイナスとなりました。

当第2四半期連結累計期間においては、2022年8月から顕在化した民生向け半導体の在庫調整も2023年上半年期には一段落するものと予測されておりましたが、在庫調整の回復にはまだ時間がかかる見込みです。そのため、2023年6月末時点において、スマートフォンやPCなどの需要低迷の影響から、主にそれら機器で使用される半導体を中心にだぶつき感が否めない状況が続いており、顧客の各工場が、生産調整に入っていることから当第2四半期連結累計期間中の受注は低調に推移しました。顧客の新規設備投資は当社第3四半期以降に開始される見込みです。

以上より、当第2四半期連結累計期間の売上高は186,416千円にとどまり、営業損失249,453千円、親会社株主に帰属する四半期純損失240,594千円を計上しております。また、営業キャッシュ・フローは、306,840千円のマイナスとなりました。

上記のとおり、継続的な営業損失及び営業キャッシュフローのマイナスが発生している状況にあり、当社グループには継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社グループはこうした状況を早期に解消又は改善すべく、以下の対応策を継続して実施しております。

### 事業施策

#### 1. 中国国内での受注販売活動の促進

まず、上記で述べたように2022年8月から顕在化していた民生向け半導体の在庫調整も2023年上半年中には一段落するものと予測されておりましたが、回復にはまだ時間がかかる状況であり、半導体チップ、特に民生機器の一部である、スマートフォンやPC、そしてIT情報端末機器などの半導体製品にだぶつき感が発生し、各半導体工場における在庫抑制を目的とした生産調整が発生しました。そのためスマートフォンやPC向けパネルそしてパネルを駆動するLCDドライバーチップ等の在庫増が嫌気され、デザインハウス及び大手OSATを中心に工場の稼働率は回復の兆しはあるものの、現時点では7割から8割程度であり、市場は新規設備投資に慎重な姿勢を崩しておりません。しかし、2024年を含む中期的には、自動車の電動化、再生エネルギー関連及び5Gへの投資需要が強く見込まれており、また、急速に需要が高まっている生成人工知能(AI)も半導体チップの需要を押し上げる要因となっていることから、市場は力強く成長すると見られております(Electronic Engineering Timesより、以下「EETIMES」という。)

また、近年の半導体の複雑化や集積度向上(例、線幅4nmから2nm)は半導体の機能の増加を意味し、検査時間の伸長に繋がります。しかしながら、同時に量産性も要求されるため、半導体検査市場は、装置能力の向上に加えて装置台数の増加が期待される方向と考えられております。

当社グループが「主力装置」と位置付けるLCDドライバIC検査装置は、スマートフォンやPC等の情報端末の液晶パネルの駆動に使われる「ディスプレイドライバーIC」の検査に使用されております。また、それら情報端末には、「CMOSイメージセンサーIC」、「ロジックIC」など多種に渡る周辺半導体デバイスが使われております。現状足元では、上記のように半導体市場の足踏み状態が続いておりますが、中長期的には需要も戻り、大きな伸びが期待される分野です。

上述のような理由から当第2四半期連結累計期間中では、受注は低迷致しましたが、当社の主力検査装置「WTS-577SR」につきましては、2021年から販売を開始し、当第2四半期連結累計期間において、進化する新デバイスに向けた装置の貸出しを伴うベンチマークを積極的に進め、お客様から量産ラインへの投入評価をいただくことができました。

2023年の半導体市場は、世界半導体市場統計(WSTS)や日本貿易振興機構(JETRO)等の予想では、民生向け半導体(スマートフォン、PC向け半導体等)を中心として、依然として生産調整が2023年後半まで続くとの見方があります。他方、半導体製造装置セクターにおいては、2023年前半は落ち込むが後半から2024年にかけて徐々に回復との予測もあり、当社においては、半導体検査装置の受注は2023年2月14日に公表している通期予想に組込んでおります。

新戦略として、2023年3月6日に開示いたしましたとおり、新たに日本における大手再生シリコンウエーハ製造会社である株式会社RSテクノロジーズ(東京都品川区、代表取締役 方 永義)を販売店に迎え、国内外の受注拡大を狙います。

また、当社の中国製造子会社「偉恩測試技術(武漢)有限公司」(以下、「ウインテスト武漢」という。)の営業体制の拡大強化を行い、特に中国、台湾においての直接受注を目指します。また、海外営業と海外アフターサポート体制の拡充を進め、営業活動の再構築を図ってまいります。

次に、ウインテスト武漢においては、顧客対応力の強化、更なる最終組立工程の製造品質の向上に取り組み、中国国内市場への深耕を図ってまいります。

さらに中国市場攻略のスピードアップを進めるため、ウインテスト武漢において、大手優良デザインハウス数社に的を絞った戦略を取り、関連するOSATへの貸出を進め、営業・納入・サポートと一貫体制を敷き、顧客からの信頼獲得を図ってまいります。

## 2. 技術開発の強化

先端口ジックIC検査装置（1024チャンネル、820Mbps）に関しては、第1四半期に前倒しで一部機能のリリースを行い、引続き次世代向け機能としてロジックパターンスピードが1,600Mbpsとなる高速リソースの開発を継続しており、当第4四半期中には開発を終了し、お客様への提供を開始する予定です。更に「WTS-9000S」次世代のフラッグシップ検査装置に先立ち「WTS-577SX」のリリースを同じく当第4四半期を目途に計画をしております。

「WTS-577SX」に関して、国内、台湾、中国顧客向けを想定した開発を継続しており、多くの部分を現在開発中の次世代LCDドライバー検査装置へ共用の上、使い勝手の向上に向けて新GUIを装備し、コスト削減と市場への早期リリースができるように計画をしております。

また、新たな収益の柱を構築するための成長戦略として、当社グループがこれまで培ってきた検査技術や画像処理技術、高精度センサー技術、データ解析技術を応用し、且つ当社、ウインテスト武漢の技術陣に加え、現地有力企業より営業方面・技術方面での協力体制を構築することで、2025年までに、今後市場拡大が見込まれるシステムオンチップ(SoC)市場や汎用デジタル市場等の検査分野、そしてM&Aも計画し、日本市場においても注目を集めるパワーデバイス検査分野への進出を目指し、資本提携や協力体制を積極的に進め、新規市場参入、対応可能検査範囲の拡充と展開を行い、収益基盤の拡充に取り組んでまいります。

## 3. 隣接領域の展開と製品化

検査装置向け工場FA化機器技術（「自重補償機構技術」）については、学校法人慶應義塾大学慶應義塾先端科学技術研究センターと共同開発を進めており、特許等の申請については、既にお知らせのとおり手続きは終了しております。当該技術は当社の検査装置とウエーハ搬送装置との間のドッキングアダプター（以下「ポゴタワー」という。）の着脱（約25kg～30kg）をオペレーター人で簡単に安全に行うための補助アーム（以下「マニピュレータ」という。）で製品化を目指し、当面の目標として、その搬送可能重量を50kg前後で製品化を行います。現在は、製品の製造準備に取り掛かっており、先端ロボット等の開発製造をロボット等製造事業者様と協議を開始いたしました。また当該技術は、「半導体製造工場内FA化システム」、「物流搬送システム」並びに「介護等」への応用が可能と考えております。

奈良県立大学と進めております脈波（BCG, ECG）を利用したヘルスケア管理システムは、同大学並びに株式会社TAOS研究所とアライアンスを組み、製品化を行いました。2023年3月9日に開示しました「IoTセンサーを活用したセルフヘルスケア機器の販売開始決定及び価格に関するお知らせ」に記載いたしましたとおり、2023年4月1日より一部のお客様を中心に試験販売を開始いたしました。なお、当該製品の製造に関しましては当社大阪事業所で製造を行うように準備を進めており、2023年9月から順次市場投入を計画しております。また、製品の納品後もアップデートによる機能の追加、検査項目の拡充を積極的に進め、地域医療に貢献できるようにしてまいります。なお、機器の詳細につきましては、当社WEBページをご参照ください。

## 財務施策

財務面については、事業拡張を考えた財務戦略として、筆頭株主である武漢精測と諮りながら、武漢精測グループ及び投資機関からの資本増強あるいは同グループからの借入を計画し、資金確保についての施策を今後とも継続実施してまいります。

以上の施策をもって抜本的な改善をしていく予定ですが、アフターコロナ、テレワーク需要の減少などの影響で半導体市場は、在庫の積み上がりを嫌い、生産調整から設備投資の大幅な減退を受けて大きく低迷しております。当社がメイン市場とする海外の新規受注並びに受注済み検査装置の出荷、売上は、中国経済が上向くと見込まれる当年度半ば以降となります。事業施策及び財務施策の実現可能性は市場の状況、需要動向等の今後の外部環境の影響を受けること、資金の調達についても確約されるものではないことから、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しております。

なお、当四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を当四半期連結財務諸表に反映しておりません。

(会計方針の変更)

(時価の算定に関する会計基準の適用方針)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-21項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。

なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

(追加情報)

前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定において重要な変更はありません。

各国政府の政策を見極めながら、当社グループの業績及び財務状況への影響を最小限にすべく、状況を注視しながら対応してまいります。

(四半期連結損益計算書関係)

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
役員報酬	24,372千円	21,150千円
給料及び手当	99,161千円	89,159千円
研究開発費	125,934千円	113,597千円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
現金及び預金勘定	307,041千円	232,488千円
預入期間が3か月を超える定期預金	-千円	-千円
現金及び現金同等物	307,041千円	232,488千円

(株主資本等関係)

前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)

株主資本の著しい変動

当社は、当第2四半期連結累計期間に、第三者割当の方法による第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の権利行使による新株発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ107,578千円増加し、当第2四半期連結会計期間末において資本金が1,107,578千円、資本剰余金が1,394,064千円となっております。

当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)

株主資本の著しい変動

当社は、当第2四半期連結累計期間に、第三者割当の方法による第11回新株予約権(行使価額修正条項付)の権利行使による新株発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ216,669千円増加し、当第2四半期連結会計期間末において資本金が1,427,232千円、資本剰余金が1,713,719千円となっております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間(自2022年1月1日至2022年6月30日)

「当第2四半期連結累計期間(報告セグメントの変更等に関する事項)」に記載のとおりです。

当第2四半期連結累計期間(自2023年1月1日至2023年6月30日)

当社グループは、「半導体検査装置事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(報告セグメントの変更等に関する事項)

当社グループは、従来報告セグメントの「半導体検査装置事業」及び報告セグメントに含まない「その他」の2つにセグメントを区分しておりましたが、第1四半期連結会計期間より「半導体検査装置事業」の単一セグメントに変更しております。

これは、前連結会計年度に「その他」の事業セグメントに含まれておりましたオーディオ事業を株式会社データゲート(大阪府大阪市北区)に事業譲渡を行ったことにより、「その他」に含まれていた事業がなくなったため、報告セグメントを「半導体検査装置事業」の単一セグメントとして管理することが適切と判断したためであります。

当社の報告セグメントは単一セグメントになることから、前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間におけるセグメントの情報の記載を省略しております。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)

(単位:千円)

	報告セグメント		その他(注)	合計
	半導体検査 装置事業	合計		
収益認識の時期				
一時点で移転される財又はサービス	86,766	86,766	2,359	89,126
一定期間にわたり移転される財又はサービス	20,647	20,647	-	20,647
顧客との契約から生じる収益	107,414	107,414	2,359	109,774
その他の収益	-	-	-	-
外部顧客への売上高	107,414	107,414	2,359	109,774

(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、当社が行っているオーディオ事業を含んでおります。

当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)

(単位:千円)

	報告セグメント	
	半導体検査 装置事業	合計
収益認識の時期		
一時点で移転される財又はサービス	166,058	166,058
一定期間にわたり移転される財又はサービス	20,358	20,358
顧客との契約から生じる収益	186,416	186,416
その他の収益	-	-
外部顧客への売上高	186,416	186,416

(注)当社グループは、従来、報告セグメントの「半導体検査装置事業」及び報告セグメントに含まない「その他」の2つにセグメントを区分しておりましたが、前連結会計年度に「その他」の事業セグメントに含まれておりましたオーディオ事業を株式会社データゲート(大阪府大阪市北区)に事業譲渡を行ったことにより、「その他」に含まれていた事業がなくなったため、第1四半期連結会計期間より「半導体検査装置事業」の単一セグメントに変更しております。

## (1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
1株当たり四半期純損失( )	9円59銭	6円29銭
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純損失( )(千円)	325,120	240,594
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失( )(千円)	325,120	240,594
普通株式の期中平均株式数(株)	33,908,368	38,223,691
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	-	-

(注) 前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

## 2【その他】

該当事項はありません。

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。



# 独立監査人の四半期レビュー報告書

2023年8月10日

ウインテスト株式会社  
取締役会 御中

フロンティア監査法人  
東京都品川区

指 定 社 員 公認会計士 藤 井 幸 雄  
業 務 執 行 社 員

指 定 社 員 公認会計士 青 野 賢  
業 務 執 行 社 員

## 監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているウインテスト株式会社の2023年1月1日から2023年12月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間（2023年4月1日から2023年6月30日まで）及び第2四半期連結累計期間（2023年1月1日から2023年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ウインテスト株式会社及び連結子会社の2023年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

## 監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

## 継続企業の前提に関する重要な不確実性

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、継続的な営業損失が発生している状況にあり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該事象又は状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていない。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

## その他の事項

会社の2022年12月31日をもって終了した前連結会計年度の第2四半期連結会計期間及び第2四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して2022年8月12日付けで無限定の結論を表明しており、また、当該連結財務諸表に対して2023年3月29日付けで無限定適正意見を表明している。

## 四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

#### 四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
- ・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
- ・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

2. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。